

**深圳至正高分子材料股份有限公司  
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并  
募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管  
理委员会同意注册批复的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行 29,000,000 股股份、向南宁市先进半导体科技有限公司发行 11,915,580 股股份、向通富微电子股份有限公司发行 6,718,750 股股份、向深圳市领先半导体发展有限公司发行 5,137,307 股股份、向伍杰发行 2,343,750 股股份、向陈永阳发行 1,875,000 股股份、向张燕发行 1,750,000 股股份、向深圳海纳基石投资有限公司发行 1,562,500 股股份、向嘉兴厚熙宸浩股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,250,000 股股份、向芯绣咨询管理（上海）有限公司发行 839,075 股股份、向海南博林京融创业投资有限公司发行 781,250 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 10 亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日